



京セラ株式会社

代表取締役社長 谷本 秀夫氏

京セラ株式会社は、日本を代表する電子部品企業の一社。セラミックスを中心とする多様な技術を有しており、半導体や通信、エネルギーなど様々な業界の需要を取り込んでいる。今後は得意かつ成長分野である半導体関連などを中心に積極投資を進める方針。2029年3月期に売上高3兆円の目標を掲げ、更なる飛躍を図る京セラの代表取締役社長 谷本 秀夫氏に、各事業における今後の展望や成長戦略についてお話を伺った。

－貴社の特徴や強みについてお聞かせください。－

当社は、稲盛和夫が創業した、ファインセラミックスを祖業とする会社です。現在は電子部品や半導体関連部品、プリンター・複合機、スマートフォン、機械工具など、幅広い事業を手掛けるようになりました。太陽電池や蓄電池などエネルギー関連の製品も展開しています。このように、一つの製品に特化するのではなく、間口を広げて多角化してきたことが私たちの特徴・強みの一つです。何か一つの事業に特化するのではなく、多角化によって得た多様な技術を活かし、組み合わせることで新しいものを生み出していける企業であり続けたいと考えています。

当社は、どちらかと言えば電子部品よりも半導体関連ビジネスの方が強いという特徴もあります。そして、その半導体関連のビジネスが、ここ数年、業績を拡大させています。この分野の製品に関しては、しっかり先行投資をして、高いシェアを維持していくことも重要だ

と考えています。

また、当社の強みとして、独自の経営哲学「京セラフィロソフィ」が社員に浸透しているということも挙げられます。まじめな社員が多く、「人間として何が正しいか」を判断基準として物事を考え、行動できる会社です。更に、KDDIの株式を多く保有していることも含め、財務基盤という観点でもしっかりした会社であると思います。

－祖業であるファインセラミックスについては、将来性をどのように考えていらっしゃいますか。－

ファインセラミックスは様々なところで使われていますが、特に将来性に期待している分野が半導体関連です。近年、ファインセラミックスは半導体製造装置の部材として多く使われるようになってきました。半導体が微細化・複雑化していることで、成膜やエッチングといった製造工程では先端の製造装置ほど高い出力が

求められます。そのため、従来のアルミや金属の部材では耐久性に限界があり、部材を特殊なファインセラミック製に置き換える需要が強まっています。半導体製造装置1台当たりに搭載するセラミック部品の量が増えることで、製造装置の需要以上に私たちのファインセラミックスの需要は拡大していくものとみえています。

また、今後ファインセラミックスの搭載が増えそうな分野として、電気自動車（EV）も挙げられます。大電流を扱う機器なので、事故が起こった際の感電を防ぐため、電流を瞬時に遮断する部品が必要になります。そういった部品では筐体などにセラミックスが使われており、EVシフトによる自動車への搭載量の増加にも期待しています。

このように重要な役割を担う部材が、今後セラミックスに置き換わっていくと思われます。こういった分野のセラミックスは特殊なものであり、他社には容易に真似できない領域です。当社はファインセラミック技術でも有数の企業であり、セラミックスの需要の高まりを成長に繋げられる企業だと考えています。

—一方で、半導体は在庫調整による需要の減速が指摘されています。—

一般的に半導体の需要は一時の不足状況から一転して足踏みしていると言われていますが、データセンターなどに使われる最先端品については引き続き活況を呈しています。たしかに、パソコンやスマートフォンに関しては需要が落ち込んでいると思いますし、当社もスマートフォン向け部品などでは影響を受けています。一方で、当社の半導体パッケージはデータセンター向けが多いことからそれほど影響を受けていません。データセンター向けのAI（人工知能）チップはこれまで不足していたと思われることから、パソコンなどに比べて落ち込みは少ないとみえています。今後更にメタバースのような3D画像処理などの需要が増えていけば、データセンターにおける先端半導体の需要は増加していくでしょう。半導体の微細化が進めば、パッケージの複雑化が進み、高付加価値化も想定されます。中長期での需要拡大に期待しています。

半導体製造装置用セラミック部品についても、顧客からの引き合いは依然として強いです。3ナノや2ナノといった製造技術の開発競争などを背景に、当社顧客である半導体製造装置を手掛けるメーカーは、先端装置の受注残を豊富に持っています。当社が応えきれないほどの要請をいただいていることもあり、投資を進めて需要に応えられる体制を構築することが重要だと考えています。

—半導体以外にも、5GやADAS、IoTといったテーマが株式市場では注目されています。—

通信や自動車業界の変革は、当社の事業に影響を与えています。5Gに関しては、2025年頃からミリ波の5Gの実用化が進むとされています。ミリ波は技術的課題も多いですが、技術の進化と共に活用が広がることが期待されます。その過程では、当社も通信に関する技術で貢献できる部分があると考えています。Li-Fi（光を使った無線通信技術）といった、5Gの次の6G時代に貢献できるような研究も行っています。

ADAS（先進運転支援システム）については、安全性向上を目的に当社が開発するLiDAR（レーザーによって物体との距離を測定する技術）を活用した部品などの、市販車への搭載・量産が始まる段階になりつつあります。

IoT（様々なモノがインターネットに繋がること）では、センサーや通信技術の組み合わせが重要になってくると考えられます。当社はこれらについて幅広く技術を持っており、現在は自社の工場で様々な実験を行っています。引き続き検証を進め、ローカル5G（建物単位などで5G通信を活用すること）などIoTソリューションの提供を目指します。

—将来に向けて、新規分野にも取り組んでいらっしゃいます。—

新規分野で最も期待しているもののひとつが、GaN（窒化ガリウム）レーザーです。LEDの数倍の輝度を持ち、省エネ高効率の照明などに期待される素材です。車のヘッドライトにも一部搭載が始まっていますし、スタジアムの照明やサーチライトなどの特殊照明に使われ始めています。更にGaNは、信号も電気も送ることができるという特徴があるので、通信や光給電のほか、自動車のワイヤーハーネスの置き換え需要などでも期待できます。GaNという新しい材料を使って、当社から様々な製品を生み出せる可能性に着目しています。

2つ目は再生可能エネルギーです。まだまだ普及の余地があると考えています。例えば戸建住宅では、太陽電池に蓄電池を組み合わせることで、夜間でも日中に発電した電力を利用する仕組みができます。都市部の集合住



宅でも、燃料電池と蓄電池を組み合わせたモデルを提案していきます。当社は太陽電池、燃料電池、蓄電池の3つの電池を扱っており、これらをサブスクリプション(月額課金型)で提供するビジネスモデルについて、2023年3月期中の事業化を目標に検討を進めています。

3つ目は協働ロボットです。工場で協働ロボットを動かすには、専門的なプログラミングが必要になります。しかし、それでは中小企業などで活用するのは難しいだろうと考え、AIを使って簡易的な操作で動かすことができる製品を開発しています。2024年3月期に上市できるよう、準備を進めています。

4つ目は繊維・アパレル産業の環境負荷軽減に繋がるインクジェット捺染システムです。布地を染色する際に大量の排水が出ますが、染料ではなく顔料を使うことができれば、排水を減らすことができます。これまで顔料を使うと色合いが悪くなるのが課題でしたが、処理を工夫することで解決できる目処が立ってきました。当社のプリンターやインクジェット関連の部品に関わる技術を応用し、繊維・アパレル産業が抱える社会課題の解決に貢献できればと考えています。

－ESGに対する取り組みについても教えてください。－

環境面に関しては、2022年3月期にCO₂排出削減の目標を見直しました。2031年3月期に2020年3月期比46%削減、2051年3月期にカーボンニュートラルを目指しています。加えて、太陽光余剰電力の活用や、自社で出資しているメガソーラーの電力を利用することで、カーボンフリーを達成したいと考えています。それだけでなく、当社はソーラーパネルなど太陽光発電設備の供給を通じて社会のカーボンフリーへの貢献を目指します。

社会面に関しては、当社の経営理念の一部「全従業員の物心両面の幸福の追求」に基づき、多様な人材がより働きやすい環境づくりに取り組んでいます。

ガバナンスについては、2021年6月に社内の取締役

を減員し、取締役会の構成を見直しました。同時に、経営経験者の方が社外取締役として新たに就任されたことで、取締役会での議論はこれまで以上に活発化しています。今後は、監査役会の構成や内部監査体制も一層重要になると認識しており、引き続きコーポレートガバナンスの強化に努めていきます。

－11/25のIR Dayで、売上高3兆円の中期目標の達成時期を2029年3月期と公表しました。－

半導体の市場は2030年に2021年の2倍の規模になると言われています。そうなると、半導体パッケージの需要も当然2倍になるでしょう。半導体製造装置用部品については、製造工程の複雑化が進むことからそれ以上に拡大が進むとみられます。こういった前提などを考慮すると、当社が適切に投資を実施していけば十分に達成できる数字だろうと考えています。まずは3年先までの中期計画を現在、検討しています。売上高が1兆円から2兆円になるには22年かかりましたが、2兆円から3兆円については、今後6年程度で達成したいと思っています。

－あわせて積極投資を打ち出しています。－

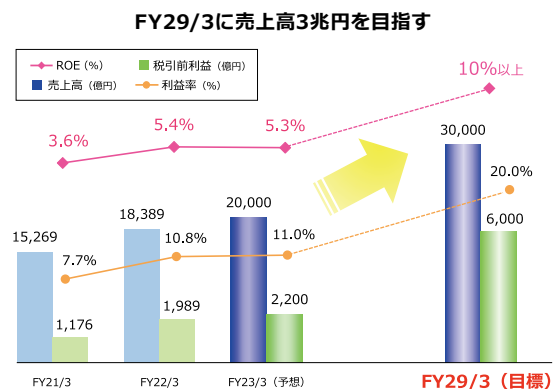
2024年3月期から2026年3月期の3年間で8,000～9,000億円の設備投資額を計画しており、得意分野かつ伸びる分野へ積極投資を行います。

特に、半導体パッケージと半導体製造装置用部品に投資全体の約半分を充てる予定です。半導体関連には従来から設備投資を行っており、需要に対する準備を進めてきたつもりでしたが、予想以上に需要が増加したことで、結果として先行投資が不十分だったという状態にあります。半導体関連の需要が一直線で伸び続けることは無いと思いますが、変動はありながらもトレンドとして2030年に向けて市場が2倍になる確度は高いと見ています。このトレンドを見据えて、需要に応

■ 図表② 新事業創造に向けた研究開発の促進



■ 図表③ 京セラグループ業績目標



える準備をする必要があるため、集中投資が必要だと考えています。

他にも、EVに使われるファインセラミック部品や、コンデンサの工場建設、水晶振動子などへの投資を予定しています。当社は水晶振動子の技術を一通り持っており、小型の振動子については高いシェアを誇っています。例えばワイヤレスイヤホンでは、充電器を含めて水晶振動子を3つ使うのですが、このような無線通信を使う機器が増えると更に追い風になります。IoT時代が本格到来すれば、需要がますます大きく増える可能性があるかとみえています。

－資本戦略にも変化が出ているようにみえます。－

稲盛が設立に関わっていた経緯で保有しているKDDI株が、財務基盤の安定に寄与してきました。この資産をどのように有効活用していくのかは、私が社長に就任した時から議論を進めてきました。そして、売却すると税金もかかることから、担保に入れて資金調達をするという結論に至っています。まずは5,000億円を一つの目安に資金調達を行い、M&Aも含め、投資などに使っていくと公表しました。資産を有効活用することで、2029年3月期の売上高3兆円の達成を目指します。そして、その際の利益率を20%くらいとすれば、ROEは10%台に上昇すると試算しています。ROEが10%で十分ということではないですが、改善は示すことができると思うため、売上高3兆円を早急を実現したいと考えています。

株主還元については、配当性向50%程度を目安に配当を実施することに加え、適宜自社株買いを実施するという方針です。売上や利益を拡大させることで、配当を増やしていくことを目指していきます。自社株買いについては、今後数年に亘り積極投資を行う局面であることとの兼ね合いになります。一方で、KDDI株を活用して調達した資金の一部を自社株買いに回すという

選択肢も一つと考えています。

－「京セラフィロソフィ」に対する考え方についても変化の可能性がありますか。－

稲盛が残してくれた「京セラフィロソフィ」が会社のベースにあることは間違いありません。「京セラフィロソフィ」の根幹を変える必要は全く無いと思っています。一方、「京セラフィロソフィ」の中には、人の心に関する部分があれば、行動指針となる部分もあります。心の部分は、人間として何が正しいかという点であり、表現も含めて変える必要はありません。ただ、行動指針については、時代に即した解釈が必要と考えます。例えば、「誰にも負けない努力」という項目があるのですが、私が入社した頃は手作業が業務の中心だったので、努力=時間でした。しかし現在では業務における手作業は減っており、成果と時間は連動しなくなっています。「誰にも負けない努力」は、長時間労働を指すのではなく、誰にも負けない集中力をもって仕事をするといった具合に、誤解がないよう伝えていく必要があると思っています。

－最後に株主・投資家の方々にメッセージをお願いします。－

当社は創業して63年になります。急成長していた頃は若い人が多く活気がありましたが、いつしか平均年齢も上がり、安定志向になってしまっていたと省みています。そこで、先輩方が残してくれた資産を有効活用し、もう一度若い人がやりたいことを実現できる会社に戻したいと思っています。フィロソフィにある「利他の心」も大切にして、若い人がやりがいをもって仕事ができ、結果として社会に貢献していける会社を目指していきます。

－本日はお忙しい中、ありがとうございました。－

(柴田 光浩)

■図表④ 高シェア・高付加価値製品への優先的な設備投資

FY23/3	FY24/3	FY25/3
		
鹿兒島園分工場 新棟	ベトナム工場 新棟	鹿兒島川内工場 新棟
稼働予定：2022年11月以降順次	稼働予定：2023年4月以降順次	稼働予定：2024年4月以降順次
主な生産品目：半導体製造装置用ファインセラミック部品	主な生産品目：セラミックパッケージ	主な生産品目：有機パッケージ・セラミックパッケージ

京セラ株式会社（6971・東証プライム）

- 1959年創業の電子部品メーカー。祖業のファインセラミックスをはじめ、様々な部品や機器を製造する。【2023年3月期会社予想（2022/10/31公表値）】
- 売上高2兆円（前期比9%増）
- 営業利益1,740億円（前期比17%増）
- 年間配当金200円/株
- 株主優待として、3月末日及び9月末日の株主名簿に記載された全株主を対象に、自社グループの製品・サービスを特別価格や特別企画にて提供。